

サーフェスマウンティングコンタクト概要 Overview: surface-mount contacts

■「SMコンタクト」とは What is an SM contact?



特長

Features

- ▶ コンパクト化 / 構造簡素化設計で省スペース実装が可能です。
- ▶ 不意な引っかけによるバネ破損を防止する構造付きです。(SM-I、SM-S は除く)
- ▶ プリント基板へは自動実装に対応したエンボステーピングでのご納入になります。
- ▶ ピンポイントで低圧縮から確実なGND接地が可能です。
- ▶ 厳しい環境下においても性能を維持します。

The contacts are smaller and structures are simplified to save space on a PCB. Some series of contacts are designed to protect the spring from damage if they catch in or on something. (SM-A/SM-V/SM-Z/SM-D)
The contacts can be delivered on an embossed carrier tape to facilitate automatic surface mounting.
These contacts ground target areas with pinpoint accuracy, even at low compression. The contacts maintain their performance in severe operating environments.

用途

Applications

- ▶ プリント基板上のシールドケースやヒートシンクのグラウンド対策。
- ▶ グランドパターンの接地。

Grounding for shield cases and heatsinks on PCBs
Grounding for ground patterns

カスタム設計

Custom design

お客様がご要望されるサイズ、形状、仕様に合わせ製品設計をいたします。

ご要望の際には、弊社営業担当までご相談下さい。

The contacts can be designed to specified dimensions, shapes, and specifications. Ask a sales representative for more information.

推奨リフロー温度プロファイル

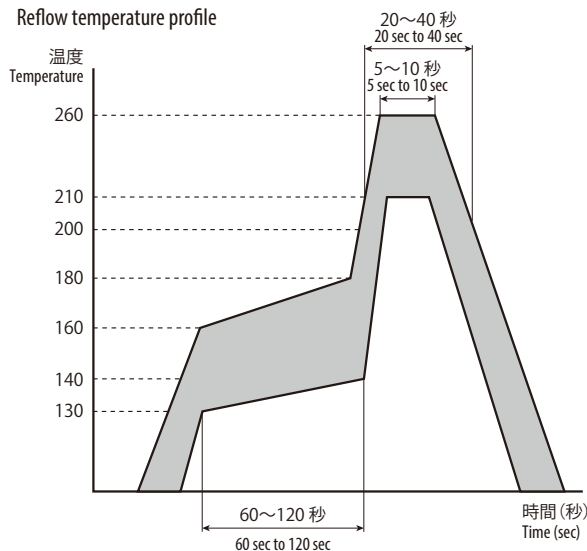
Recommended reflow temperature profile

- ▶ 予備加熱（プリヒート）
150°C ± 10°C (但し初期 130 ~ 160°C)
60 ~ 120 秒 (最終 140 ~ 180°C)
- ▶ 本加熱
リフロー温度：200 ~ 230°C (20 ~ 40 秒)
ピーク温度：210 ~ 260°C (5 ~ 10 秒)
- ▶ リフロー温度プロファイル図

Preheating
150°C ± 10°C (130°C to 160°C at start)
60 sec to 120 sec (140°C to 180°C at end)

Heating
Reflow temperature: 200°C to 230°C (20 sec to 40 sec)
Peak temperature: 210°C to 260°C (5 sec to 10 sec)

Reflow temperature profile

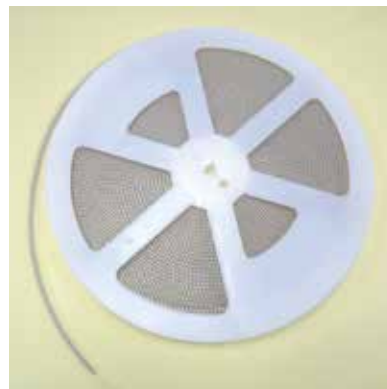


使用上の注意事項

Precautions

- ▶ 過度な衝撃を製品に与えないで下さい。
チップマウンターでの吸着確認、自動実装をご確認のうえ、ご使用下さい。
- ▶ 異金属への接触については金属相性により酸化を招く可能性があります。
- ▶ 圧縮を加えた状態で、長時間激しい振動がかかると金属疲労によりバネが破損する可能性がありますのでご注意ください。
- ▶ 使用上、ご不明な点はお問い合わせ下さい。

Avoid subjecting the product to excessive shock.
Make sure the contacts are held securely in place by vacuum and appropriately surface mounted by a chip mounter before use.
Oxidization may result if the contacts come into contact with certain types of metal. Subjecting a compressed contact to violent vibrations for many hours may result in metal fatigue and failure of the spring.
Please contact us if you have any questions.



納入はリールでの納入となります。
The contacts will be delivered on a reel.

SMコンタクト推奨弾性使用範囲表

Recommended elastic use range list

品番 Part No.	初期 高さ Initial height (mm)	最小 Min (mm)	最大 Max (mm)	■ 推奨弾性使用範囲 Recommended elastic use range																	
				0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	9.0	11.0
SM-E241512-PB	1.5	0.9	1.2		■																
SM-C141514TGCS	1.5	0.9	1.2		■																
SM-T221610SGCS	1.6	0.9	1.2		■																
SM-Q362118CG	2.1	1.3	1.6			■															
SM-Q342620CG	2.6	1.8	2.3				■														
SM-Q373320TG	3.3	1.9	2.8				■														
SM-T253012TGCS	3.0	2.1	2.6				■														
SM-W353038-PB	3.0	2.2	2.6				■														
SM-Q403925TG	3.9	2.4	3.6				■														
SM-D733735-PB	3.7	2.5	3.4				■														
SM-S383520TG	3.5	2.5	3.2				■														
SM-Q413720CG	3.7	2.6	3.2				■														
SM-S404030TG	4.0	2.8	3.8				■														
SM-A364030A	4.0	2.8	3.5				■														
SM-V384022-PB	4.0	3.0	3.8				■														
SM-485030-I	5.0	3.1	4.7				■														
SM-S454520TG	4.5	3.5	4.1				■														
SM-Q505527TG	5.5	3.6	4.4				■														
SM-D906039-PB	6.0	3.7	5.7				■														
SM-S505020TG	5.0	3.8	4.6				■														
SM-Q505125CG	5.1	3.8	4.7				■														
SM-V506022-PB	6.0	4.0	5.5				■														
SM-Q546325CG	6.3	4.0	5.8				■														
SM-Z365325-PB	5.3	4.5	5.0							■											
SM-S706225TG	6.2	4.7	5.6							■											
SM-S707525TG	7.5	4.8	7.2											■							
SM-S606720TG	6.7	5.0	6.2											■							
SM-S709025TG	9.0	5.6	8.7												■						
SM-S701125TG	11.0	6.7	10.5													■					



SM-E type

SM-E241512-PB

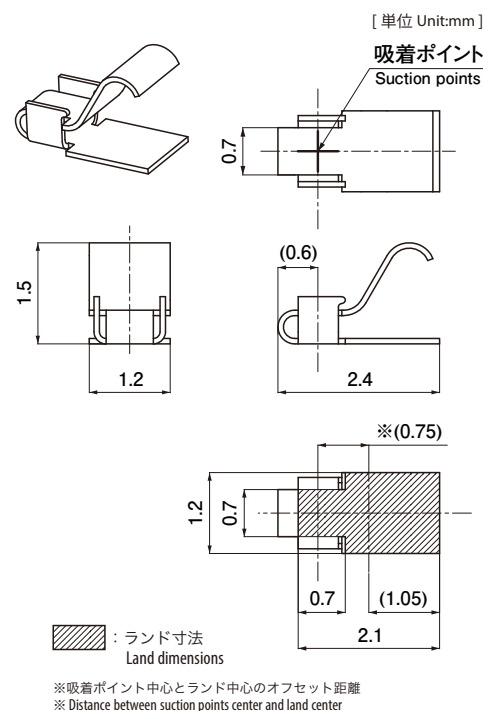
- 推奨弾性使用範囲 / Recommended available Height 高さ = 0.9 ~ 1.2mm
Height: 0.9 mm to 1.2 mm
- 材質 / Material リン青銅 (t=0.08mm) Phosphor bronze (t=0.08mm)
- メッキ処理 / Plating 下地メッキ 全面：Niメッキ Underplating whole surface : Ni plating
ハンダ面：Snメッキ Solder area : Sn plating

特性 Physical properties

- 初期抵抗値 / Initial resistance 0.1Ω 以下 0.1Ω or less
- 圧縮荷重 / Compressive load 高さ：0.9mm時：0.38 N (参考値)
Height : 0.9mm : 0.38N (Reference value)

標準梱包数量 Standard packaging quantity

- 梱包形態 / Packaging テーピング Taping
- 数量 / Quantity 10,000ヶ (リール) 10,000/reel



SM-C type

SM-C141514TGCS

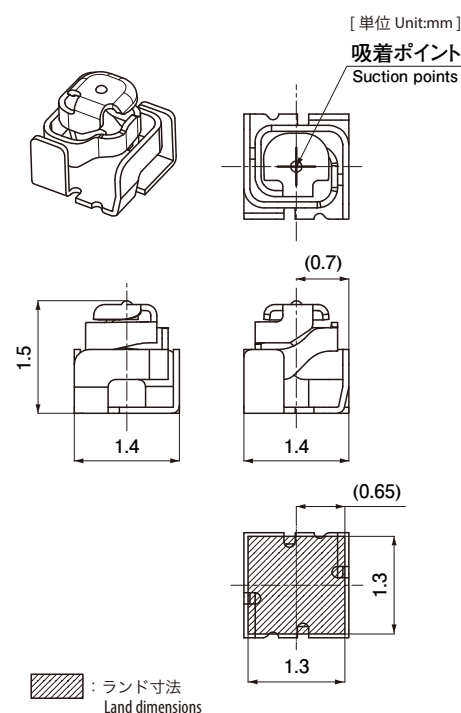
- 推奨弾性使用範囲 / Recommended available Height 高さ = 0.9 ~ 1.2mm
Height: 0.9 mm to 1.2 mm
- 材質 / Material チタン銅 (t=0.08mm) Titanium copper (t=0.08mm)
- メッキ処理 / Plating 下地メッキ 全面：Niメッキ Underplating whole surface : Ni plating
コンタクト面、ハンダ面又は全面：Auメッキ
Contact area, solder area or whole surface : Au plating

特性 Physical properties

- 初期抵抗値 / Initial resistance 0.05Ω 以下 0.05Ω or less
- 圧縮荷重 / Compressive load 高さ：0.9mm時：1.79 N (参考値)
Height : 0.9mm : 1.79N (Reference value)

標準梱包数量 Standard packaging quantity

- 梱包形態 / Packaging テーピング Taping
- 数量 / Quantity 8,100ヶ (リール) 8,100/reel



SM-T type



SM-T221610SGCS

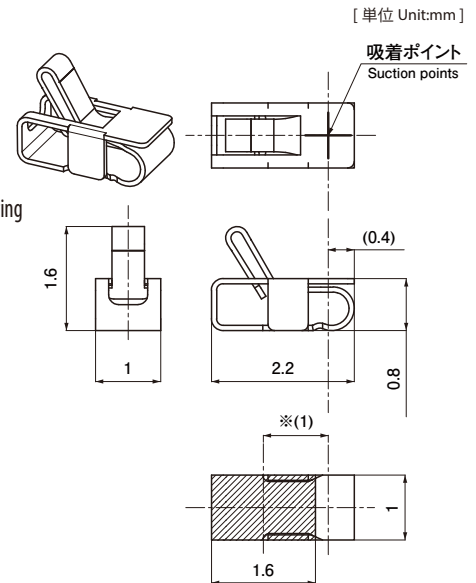
- ▶ 推奨弾性使用範囲 /Recommended available Height 高さ=0.9 ~ 1.2mm
Height: 0.9 mm to 1.2 mm
- ▶ 材 質 /Material ステンレス鋼 (t=0.08mm) Stainless steel (t=0.08mm)
- ▶ メッキ処理 /Plating 下地メッキ 全面：Niメッキ Underplating whole surface : Ni plating
コンタクト面、ハンダ面又は全面：金フラッシュ
Contact area, solder area or whole surface : Gold flash

特 性 Physical properties

- ▶ 初期抵抗値 /Initial resistance 0.1Ω以下 0.1Ω or less
- ▶ 圧縮荷重 /Compressive load 高さ：0.9mm時：1.31 N (参考値)
Height : 0.9mm : 1.31N (Reference value)

標準梱包数量 Standard packaging quantity

- ▶ 梱包形態 /Packaging テーピング Taping
- ▶ 数 量 /Quantity 7,400ヶ (リール) 7,400/reel



SM-T253012TGCS

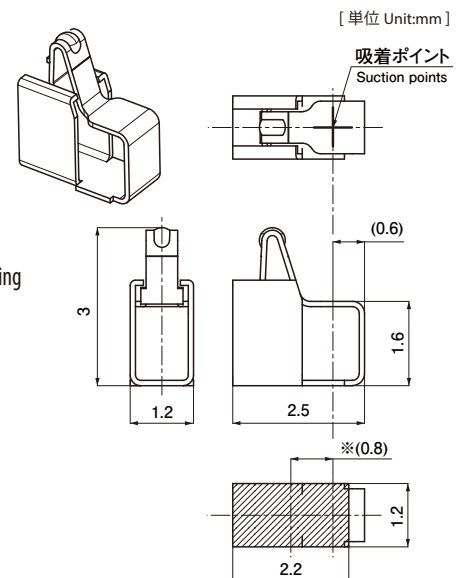
- ▶ 推奨弾性使用範囲 /Recommended available Height 高さ=2.1 ~ 2.6mm
Height: 2.1 mm to 2.6 mm
- ▶ 材 質 /Material チタン銅 (t=0.1mm) Titanium copper (t=0.1mm)
- ▶ メッキ処理 /Plating 下地メッキ 全面：Niメッキ Underplating whole surface : Ni plating
コンタクト面、ハンダ面又は全面：金フラッシュ
Contact area, solder area or whole surface : Gold flash

特 性 Physical properties

- ▶ 初期抵抗値 /Initial resistance 0.05Ω以下 0.05Ω or less
- ▶ 圧縮荷重 /Compressive load 高さ：2.1mm時：1.22 N (参考値)
Height : 2.1mm : 1.22N (Reference value)

標準梱包数量 Standard packaging quantity

- ▶ 梱包形態 /Packaging テーピング Taping
- ▶ 数 量 /Quantity 4,900ヶ (リール) 4,900/reel



ランド寸法
Land dimensions

※吸着ポイント中心とランド中心のオフセット距離
※ Distance between suction points center and land center



SM-W type

SM-W353038-PB

- 推奨弾性使用範囲 / Recommended available Height 高さ = 2.2 ~ 2.6mm
Height: 2.2 mm to 2.6 mm
- 材質 / Material リン青銅 (t=0.1mm) Phosphor bronze (t=0.1mm)
- メッキ処理 / Plating 下地メッキ 全面: Niメッキ Underplating whole surface: Ni plating
ハンダ面: Snメッキ Solder area: Sn plating

特性

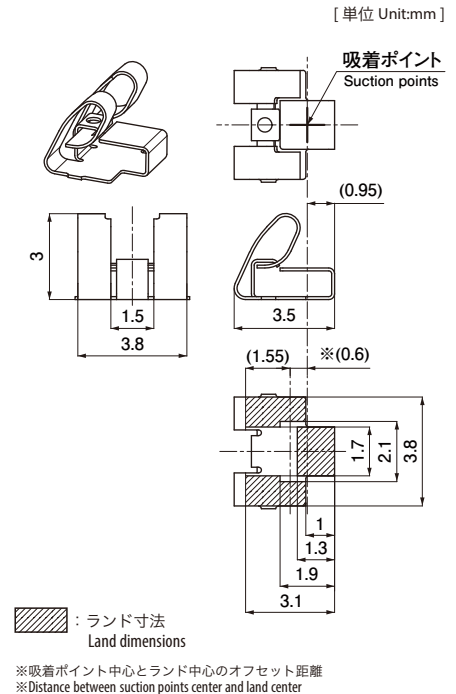
Physical properties

- 初期抵抗値 / Initial resistance 0.05Ω以下 0.05 Ω or less
- 圧縮荷重 / Compressive load 高さ: 2.2mm時: 2.60 N (参考値)
Height: 2.2mm: 2.60N (Reference value)

標準梱包数量

Standard packaging quantity

- 梱包形態 / Packaging テーピング Taping
- 数量 / Quantity 3,500ヶ (リール) 3,500/reel



SM-A type

SM-A364030A

- 推奨弾性使用範囲 / Recommended available Height 高さ = 2.8 ~ 3.5mm
Height: 2.8 mm to 3.5 mm
- 材質 / Material ベリリウム銅 (t=0.1mm) Beryllium copper (t=0.1mm)
- メッキ処理 / Plating 下地メッキ 全面: Niメッキ Underplating whole surface: Ni plating
ハンダ面: Snメッキ Solder area: Sn plating

特性

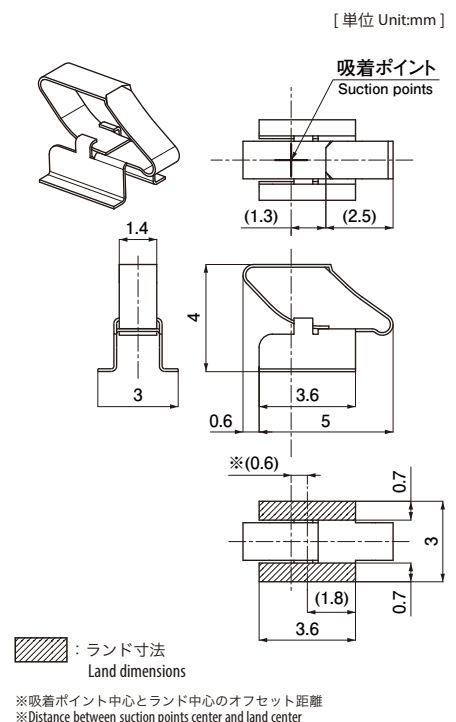
Physical properties

- 初期抵抗値 / Initial resistance 0.05Ω以下 0.05 Ω or less
- 圧縮荷重 / Compressive load 高さ: 2.8mm時: 1.56 N (参考値)
Height: 2.8mm: 1.56N (Reference value)

標準梱包数量

Standard packaging quantity

- 梱包形態 / Packaging テーピング Taping
- 数量 / Quantity 2,500ヶ (リール) 2,500/reel





SM-I type

SM-485030-I

- 推奨弾性使用範囲 / Recommended available Height 高さ = 3.1 ~ 4.7mm
Height: 3.1 mm to 4.7 mm
- 材質 / Material リン青銅 (t=0.08mm) Phosphor bronze(t=0.08mm)
- メッキ処理 / Plating 下地メッキ 全面：Niメッキ Underplating whole surface : Ni plating
ハンダ面：Snメッキ Solder area : Sn plating

特性

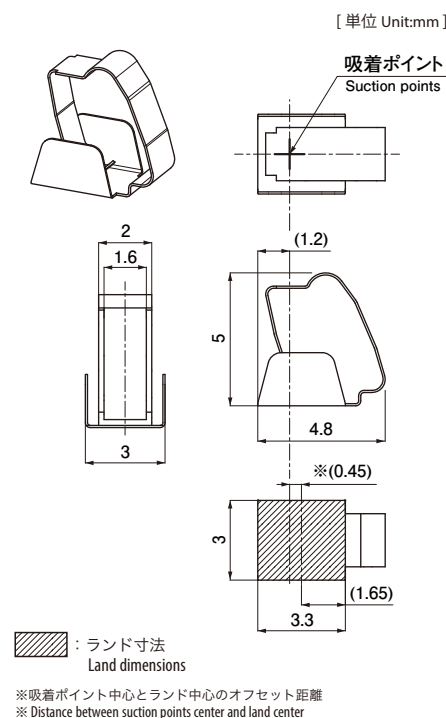
Physical properties

- 初期抵抗値 / Initial resistance 0.05Ω以下 0.05 Ω or less
- 圧縮荷重 / Compressive load 高さ：3.1mm時：0.90 N (参考値)
Height : 3.1mm : 0.90N (Reference value)

標準梱包数量

Standard packaging quantity

- 梱包形態 / Packaging テーピング Taping
- 数量 / Quantity 2,000ヶ (リール) 2,000/reel



SM-Z type

SM-Z365325-PB

- 推奨弾性使用範囲 / Recommended available Height 高さ = 4.5 ~ 5.0mm
Height: 4.5 mm to 5.0 mm
- 材質 / Material リン青銅 (t=0.15mm) Phosphor bronze(t=0.15mm)
- メッキ処理 / Plating 下地メッキ 全面：Niメッキ Underplating whole surface : Ni plating
ハンダ面：Snメッキ Solder area : Sn plating

特性

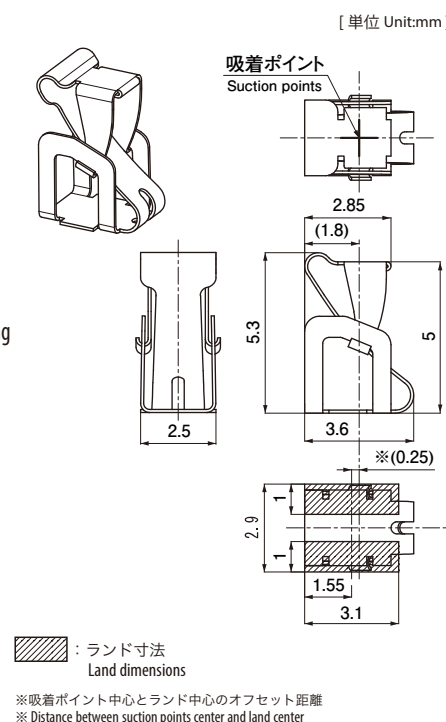
Physical properties

- 初期抵抗値 / Initial resistance 0.05Ω以下 0.05 Ω or less
- 圧縮荷重 / Compressive load 高さ：4.5mm時：3.17 N (参考値)
Height : 4.5mm : 3.17N (Reference value)

標準梱包数量

Standard packaging quantity

- 梱包形態 / Packaging テーピング Taping
- 数量 / Quantity 2,000ヶ (リール) 2,000/reel





SM-D type

[単位 Unit:mm]

SM-D733735-PB

推奨弾性使用範囲 / Recommended available Height 高さ = 2.5 ~ 3.4mm
Height: 2.5 mm to 3.4 mm

材質 / Material リン青銅 (t=0.1mm) Phosphor bronze(t=0.1mm)

メッキ処理 / Plating 下地メッキ 全面：Niメッキ Underplating whole surface : Ni plating
ハンダ面：Snメッキ Solder area : Sn plating

特 性 Physical properties

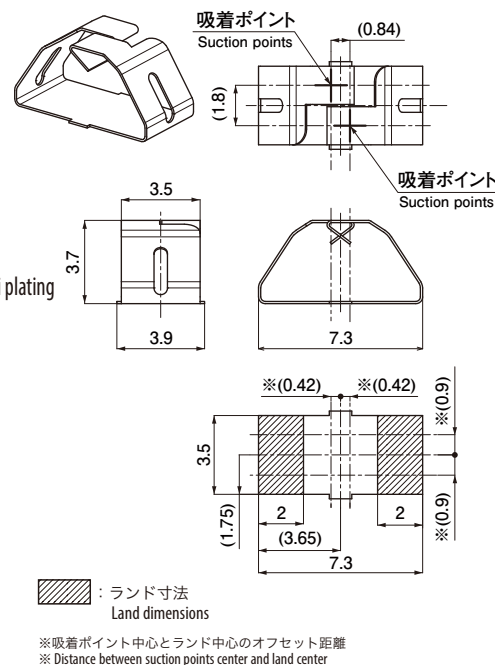
初期抵抗値 / Initial resistance 0.05Ω以下 0.05 Ω or less

圧縮荷重 / Compressive load 高さ：2.5mm時：4.26 N (参考値)
Height : 2.5mm : 4.26N (Reference value)

標準梱包数量 Standard packaging quantity

梱包形態 / Packaging テーピング Taping

数 量 / Quantity 2,500ヶ (リール) 2,500/reel



SM-D906039-PB

推奨弾性使用範囲 / Recommended available Height 高さ = 3.7 ~ 5.7mm
Height: 3.7 mm to 5.7 mm

材質 / Material リン青銅 (t=0.1mm) Phosphor bronze(t=0.1mm)

メッキ処理 / Plating 下地メッキ 全面：Niメッキ Underplating whole surface : Ni plating
ハンダ面：Snメッキ Solder area : Sn plating

特 性 Physical properties

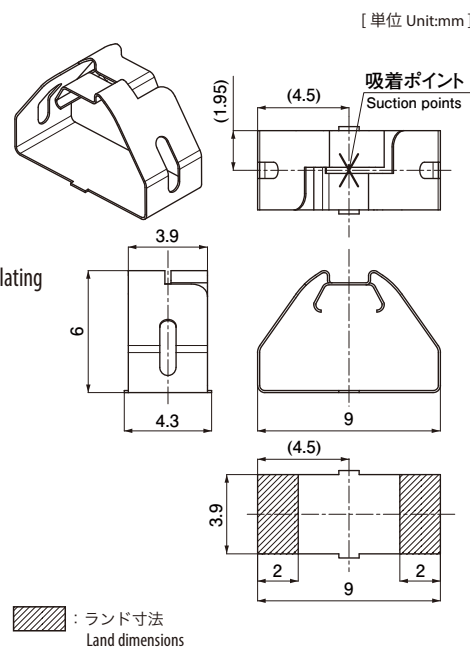
初期抵抗値 / Initial resistance 0.05Ω以下 0.05 Ω or less

圧縮荷重 / Compressive load 高さ：3.7mm時：3.38 N (参考値)
Height : 3.7mm : 3.38N (Reference value)

標準梱包数量 Standard packaging quantity

梱包形態 / Packaging テーピング Taping

数 量 / Quantity 1,800ヶ (リール) 1,800/reel





SM-V type

SM-V384022-PB

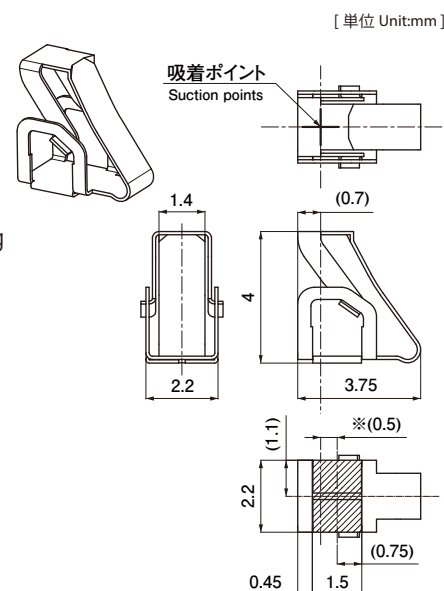
- ▶ 推奨弾性使用範囲 /Recommended available Height 高さ=3.0 ～ 3.8mm
Height: 3.0 mm to 3.8 mm
- ▶ 材 質 /Material..... リン青銅 (t=0.1mm) Phosphor bronze(t=0.1mm)
- ▶ メッキ処理 /Plating.... 下地メッキ 全面：Niメッキ Underplating whole surface : Ni plating
ハンダ面：Snメッキ Solder area : Sn plating

特 性 Physical properties

- ▶ 初期抵抗値 /Initial resistance..... 0.05Ω以下 0.05 Ω or less
- ▶ 圧縮荷重 /Compressive load..... 高さ：3.0mm時：0.96 N (参考値)
Height : 3.0mm : 0.96N (Reference value)

標準梱包数量 Standard packaging quantity

- ▶ 梱包形態 /Packaging テーピング Taping
- ▶ 数 量 /Quantity 5,000ヶ(リール) 5,000/reel



SM-V506022-PB

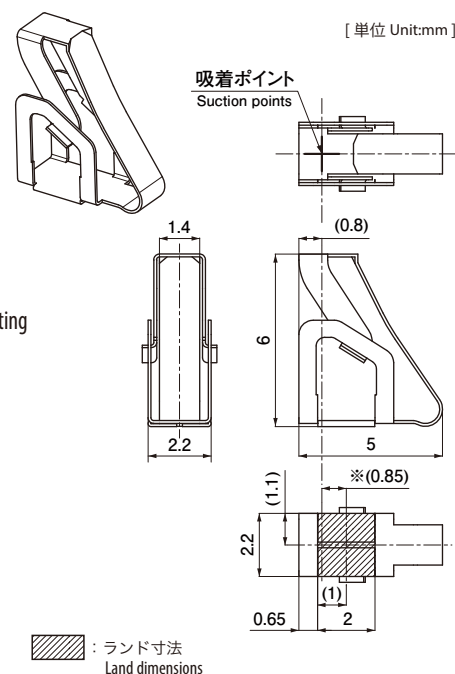
- ▶ 推奨弾性使用範囲 /Recommended available Height 高さ=4.0 ～ 5.5mm
Height: 4.0 mm to 5.5 mm
- ▶ 材 質 /Material..... リン青銅 (t=0.1mm) Phosphor bronze(t=0.1mm)
- ▶ メッキ処理 /Plating.... 下地メッキ 全面：Niメッキ Underplating whole surface : Ni plating
ハンダ面：Snメッキ Solder area : Sn plating

特 性 Physical properties

- ▶ 初期抵抗値 /Initial resistance..... 0.05Ω以下 0.05 Ω or less
- ▶ 圧縮荷重 /Compressive load..... 高さ：4.0mm時：0.34 N (参考値)
Height : 4.0mm : 0.34N (Reference value)

標準梱包数量 Standard packaging quantity

- ▶ 梱包形態 /Packaging テーピング Taping
- ▶ 数 量 /Quantity 1,500ヶ(リール) 1,500/reel



ハランド寸法
Land dimensions

※吸着ポイント中心とランド中心のオフセット距離
※ Distance between suction points center and land center



SM-Q type

SM-Q362118CG

■ 推奨弾性使用範囲 / Recommended available Height 高さ = 1.3 ~ 1.6mm
Height: 1.3 mm to 1.6 mm

■ 材 質 / Material 銅合金 (t=0.08mm) Copper alloy(t=0.08mm)

■ メッキ処理 / Plating 下地メッキ 全面：Niメッキ Underplating whole surface : Ni plating
コンタクト面、ハンダ面又は全面：金フラッシュ
Contact area, solder area or whole surface : Gold flash

特 性

Physical properties

■ 初期抵抗値 / Initial resistance 0.05Ω以下 0.05 Ω or less

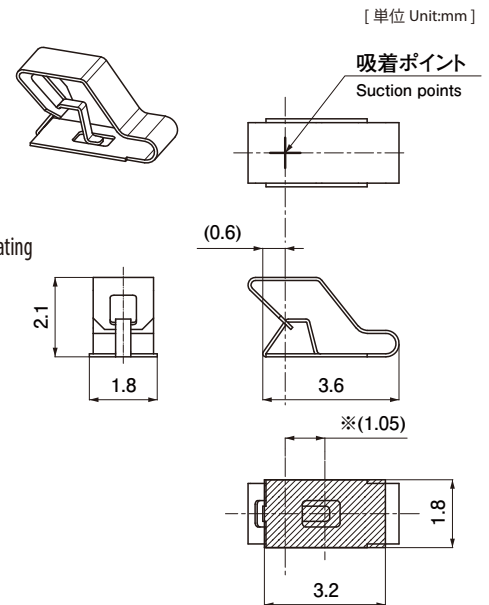
■ 圧縮荷重 / Compressive load 高さ：1.3mm時：3.04 N (参考値)
Height : 1.3mm : 3.04N (Reference value)

標準梱包数量

Standard packaging quantity

■ 梱包形態 / Packaging テーピング Taping

■ 数 量 / Quantity 7,300ヶ (リール) 7,300/reel



SM-Q342620CG

■ 推奨弾性使用範囲 / Recommended available Height 高さ = 1.8 ~ 2.3mm
Height: 1.8 mm to 2.3 mm

■ 材 質 / Material 銅合金 (t=0.08mm) Copper alloy(t=0.08mm)

■ メッキ処理 / Plating 下地メッキ 全面：Niメッキ Underplating whole surface : Ni plating
コンタクト面、ハンダ面又は全面：Auメッキ
Contact area, solder area or whole surface : Au plating

特 性

Physical properties

■ 初期抵抗値 / Initial resistance 0.05Ω以下 0.05 Ω or less

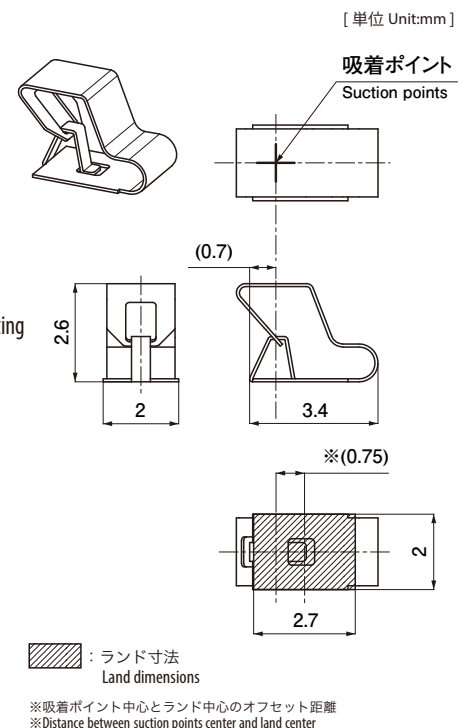
■ 圧縮荷重 / Compressive load 高さ：1.8mm時：2.77 N (参考値)
Height : 1.8mm : 2.77N (Reference value)

標準梱包数量

Standard packaging quantity

■ 梱包形態 / Packaging テーピング Taping

■ 数 量 / Quantity 5,000ヶ (リール) 5,000/reel



SM-Q373320TG**近日発売**

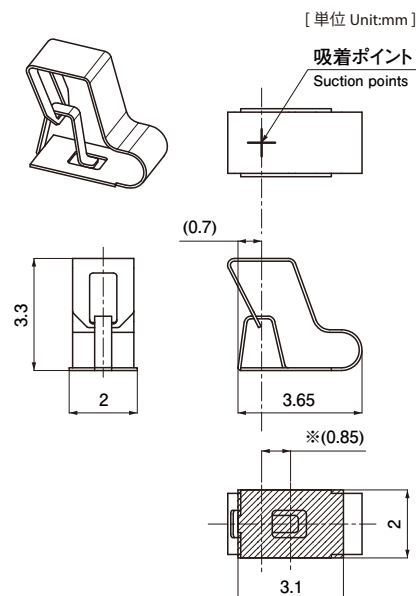
- 推奨弾性使用範囲 / Recommended available Height 高さ = 1.9 ~ 2.8mm
Height: 1.9 mm to 2.8 mm
- 材質 / Material チタン銅 (t=0.08mm) Titanium copper (t=0.08mm)
- メッキ処理 / Plating 下地メッキ 全面：Niメッキ Underplating whole surface : Ni plating
全面：金フラッシュ Whole surface : Gold flash

特性*Physical properties*

- 初期抵抗値 / Initial resistance 0.05Ω以下 0.05 Ω or less
- 圧縮荷重 / Compressive load 高さ：1.9mm時：5.71 N (参考値)
Height : 1.9mm : 5.71N (Reference value)

標準梱包数量*Standard packaging quantity*

- 梱包形態 / Packaging テーピング Taping
- 数量 / Quantity 4,800ヶ (リール) 4,800/reel

**SM-Q403925TG**

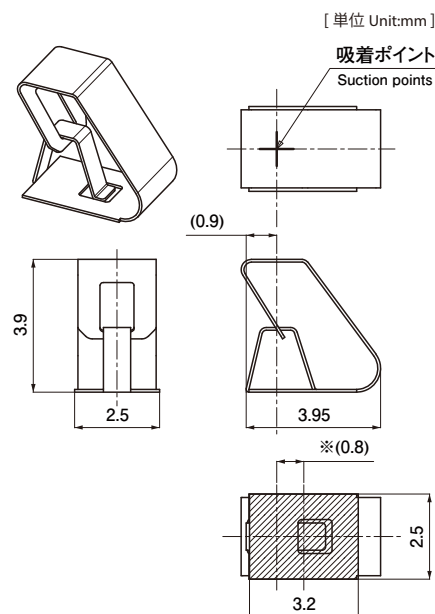
- 推奨弾性使用範囲 / Recommended available Height 高さ = 2.4 ~ 3.6mm
Height: 2.4 mm to 3.6 mm
- 材質 / Material チタン銅 (t=0.08mm) Titanium copper (t=0.08mm)
- メッキ処理 / Plating 下地メッキ 全面：Niメッキ Underplating whole surface : Ni plating
全面：金フラッシュ Whole surface : Gold flash

特性*Physical properties*

- 初期抵抗値 / Initial resistance 0.05Ω以下 0.05 Ω or less
- 圧縮荷重 / Compressive load 高さ：2.4mm時：1.82 N (参考値)
Height : 2.4mm : 1.82N (Reference value)

標準梱包数量*Standard packaging quantity*

- 梱包形態 / Packaging テーピング Taping
- 数量 / Quantity 1,900ヶ (リール) 1,900/reel

**SM-Q413720CG**

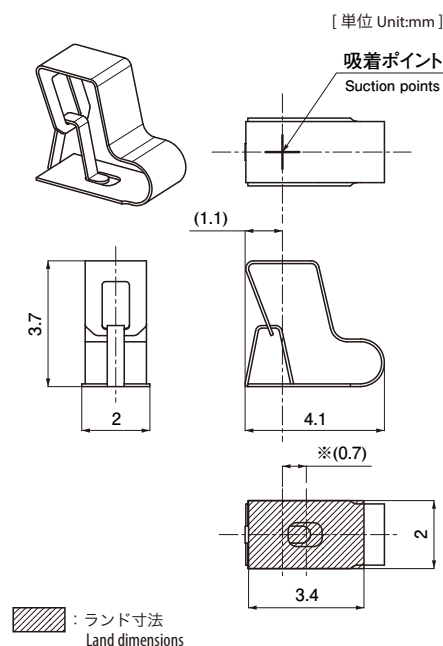
- 推奨弾性使用範囲 / Recommended available Height 高さ = 2.6 ~ 3.2mm
Height: 2.6 mm to 3.2 mm
- 材質 / Material 銅合金 (t=0.08mm) Copper alloy (t=0.08mm)
- メッキ処理 / Plating 下地メッキ 全面：Niメッキ Underplating whole surface : Ni plating
コンタクト面、ハンダ面又は全面：Auメッキ Contact area, solder area or whole surface : Au plating

特性*Physical properties*

- 初期抵抗値 / Initial resistance 0.05Ω以下 0.05 Ω or less
- 圧縮荷重 / Compressive load 高さ：2.6mm時：0.72 N (参考値)
Height : 2.6mm : 0.72N (Reference value)

標準梱包数量*Standard packaging quantity*

- 梱包形態 / Packaging テーピング Taping
- 数量 / Quantity 4,000ヶ (リール) 4,000/reel



※吸着ポイント中心とランド中心のオフセット距離
※ Distance between suction points center and land center

SM-Q505527TG

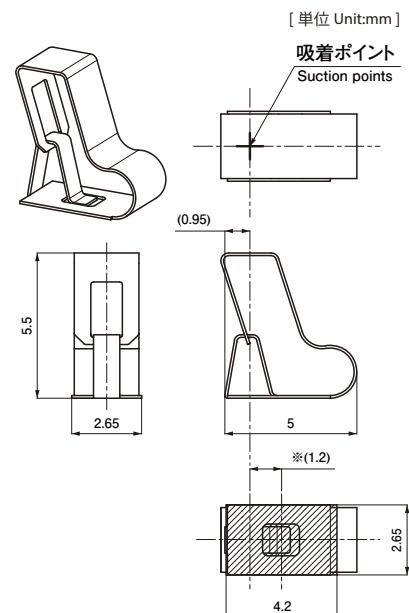
- 推奨弾性使用範囲 / Recommended available Height 高さ = 3.6 ~ 4.4mm
Height: 3.6 mm to 4.4 mm
- 材質 / Material チタン銅 (t=0.1mm) Titanium copper (t=0.1mm)
- メッキ処理 / Plating 下地メッキ 全面：Niメッキ Underplating whole surface : Ni plating
全面：金フラッシュ Whole surface : Gold flash

特性*Physical properties*

- 初期抵抗値 / Initial resistance 0.05Ω以下 0.05 Ω or less
- 圧縮荷重 / Compressive load 高さ：3.6mm時：1.15 N (参考値)
Height : 3.6mm : 1.15N (Reference value)

標準梱包数量*Standard packaging quantity*

- 梱包形態 / Packaging テーピング Taping
- 数量 / Quantity 1,400ヶ (リール) 1,400/reel

**SM-Q505125CG**

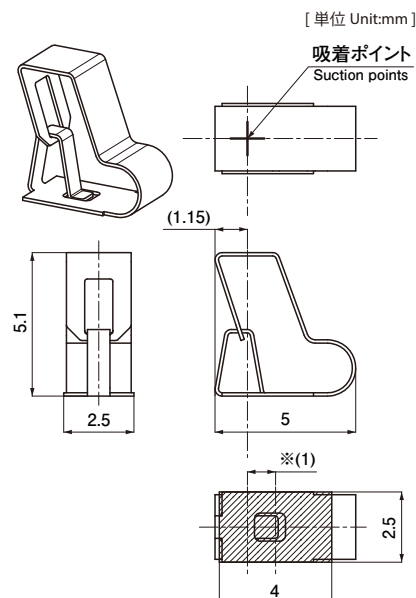
- 推奨弾性使用範囲 / Recommended available Height 高さ = 3.8 ~ 4.7mm
Height: 3.8 mm to 4.7 mm
- 材質 / Material 銅合金 (t=0.1mm) Copper alloy (t=0.1mm)
- メッキ処理 / Plating 下地メッキ 全面：Niメッキ Underplating whole surface : Ni plating
コンタクト面、ハンダ面又は全面：金フラッシュ Contact area, solder area or whole surface : Gold flash

特性*Physical properties*

- 初期抵抗値 / Initial resistance 0.05Ω以下 0.05 Ω or less
- 圧縮荷重 / Compressive load 高さ：3.8mm時：0.95 N (参考値)
Height : 3.8mm : 0.95N (Reference value)

標準梱包数量*Standard packaging quantity*

- 梱包形態 / Packaging テーピング Taping
- 数量 / Quantity 1,500ヶ (リール) 1,500/reel

**SM-Q546325CG**

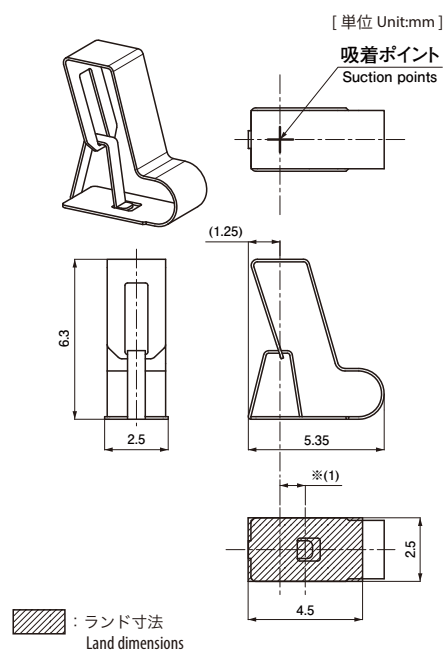
- 推奨弾性使用範囲 / Recommended available Height 高さ = 4.0 ~ 5.8mm
Height: 4.0 mm to 5.8 mm
- 材質 / Material 銅合金 (t=0.1mm) Copper alloy (t=0.1mm)
- メッキ処理 / Plating 下地メッキ 全面：Niメッキ Underplating whole surface : Ni plating
全面：金フラッシュ Whole surface : Gold flash

特性*Physical properties*

- 初期抵抗値 / Initial resistance 0.05Ω以下 0.05 Ω or less
- 圧縮荷重 / Compressive load 高さ：4.0mm時：1.14 N (参考値)
Height : 4.0mm : 1.14N (Reference value)

標準梱包数量*Standard packaging quantity*

- 梱包形態 / Packaging テーピング Taping
- 数量 / Quantity 1,200ヶ (リール) 1,200/reel



※吸着ポイント中心とランド中心のオフセット距離
※ Distance between suction points center and land center

SM-S type



SM-S383520TG

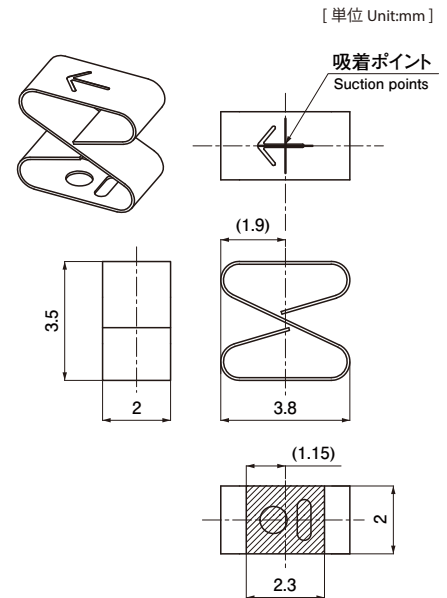
- ▶ 推奨弾性使用範囲 /Recommended available Height 高さ=2.5 ～ 3.2mm
Height: 2.5 mm to 3.2 mm
- ▶ 材 質 /Material チタン銅 (t=0.08mm) Titanium copper(t=0.08mm)
- ▶ メッキ処理 /Plating 下地メッキ 全面：Niメッキ Underplating whole surface : Ni plating
全面：金フラッシュ Whole surface : Gold flash

特 性 Physical properties

- ▶ 初期抵抗値 /Initial resistance 0.05Ω以下 0.05 Ω or less
- ▶ 圧縮荷重 /Compressive load 高さ：2.5mm時：1.75 N (参考値)
Height : 2.5mm : 1.75N (Reference value)

標準梱包数量 Standard packaging quantity

- ▶ 梱包形態 /Packaging テーピング Taping
- ▶ 数 量 /Quantity 4,500ヶ(リール) 4,500/reel



SM-S404030TG

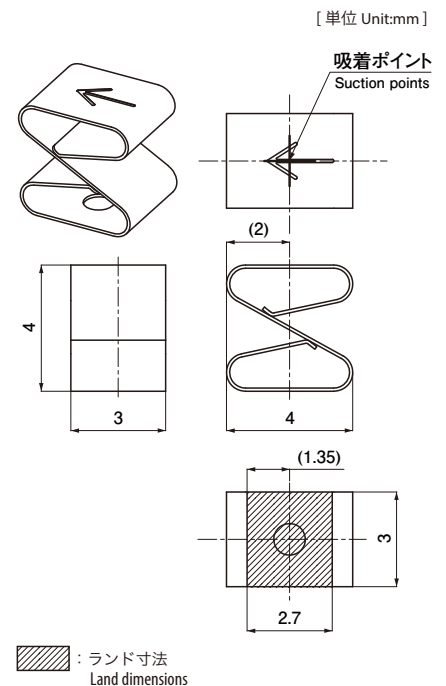
- ▶ 推奨弾性使用範囲 /Recommended available Height 高さ=2.8 ～ 3.8mm
Height: 2.8 mm to 3.8 mm
- ▶ 材 質 /Material チタン銅 (t=0.1mm) Titanium copper(t=0.1mm)
- ▶ メッキ処理 /Plating 下地メッキ 全面：Niメッキ Underplating whole surface : Ni plating
全面：金フラッシュ Whole surface : Gold flash

特 性 Physical properties

- ▶ 初期抵抗値 /Initial resistance 0.05Ω以下 0.05 Ω or less
- ▶ 圧縮荷重 /Compressive load 高さ：2.8mm時：3.99 N (参考値)
Height : 2.8mm : 3.99N (Reference value)

標準梱包数量 Standard packaging quantity

- ▶ 梱包形態 /Packaging テーピング Taping
- ▶ 数 量 /Quantity 1,900ヶ(リール) 1,900/reel



SM-S454520TG

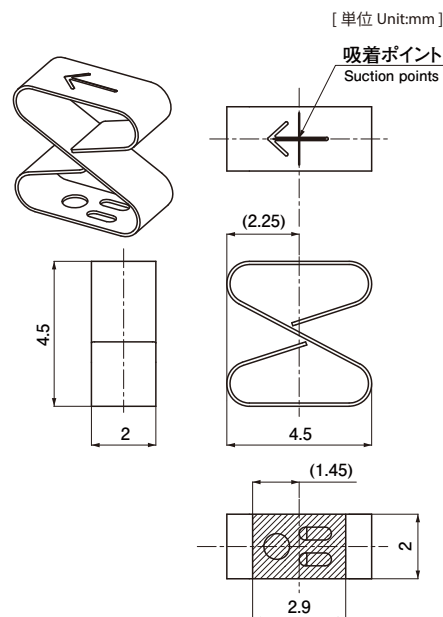
- 推奨弾性使用範囲 / Recommended available Height 高さ = 3.5 ~ 4.1 mm
Height: 3.5 mm to 4.1 mm
- 材質 / Material チタン銅 (t=0.1mm) Titanium copper (t=0.1mm)
- メッキ処理 / Plating 下地メッキ 全面：Niメッキ Underplating whole surface : Ni plating
全面：金フラッシュ Whole surface : Gold flash

特性*Physical properties*

- 初期抵抗値 / Initial resistance 0.05Ω以下 0.05 Ω or less
- 圧縮荷重 / Compressive load 高さ：3.5mm時：2.22 N (参考値)
Height : 3.5mm : 2.22N (Reference value)

標準梱包数量*Standard packaging quantity*

- 梱包形態 / Packaging テーピング Taping
- 数量 / Quantity 3,400ヶ (リール) 3,400/reel

**SM-S505020TG**

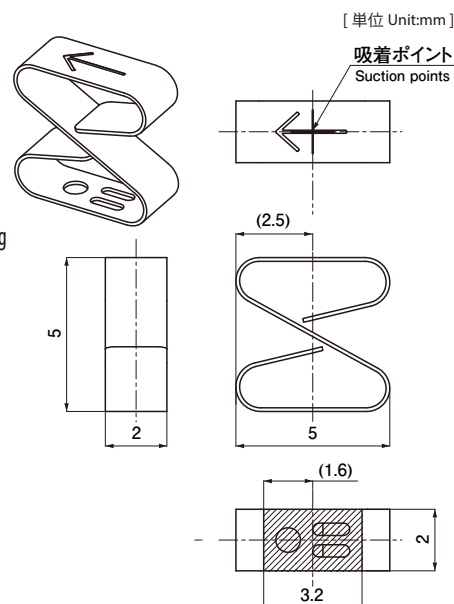
- 推奨弾性使用範囲 / Recommended available Height 高さ = 3.8 ~ 4.6 mm
Height: 3.8 mm to 4.6 mm
- 材質 / Material チタン銅 (t=0.12mm) Titanium copper (t=0.12mm)
- メッキ処理 / Plating 下地メッキ 全面：Niメッキ Underplating whole surface : Ni plating
全面：金フラッシュ Whole surface : Gold flash

特性*Physical properties*

- 初期抵抗値 / Initial resistance 0.05Ω以下 0.05 Ω or less
- 圧縮荷重 / Compressive load 高さ：3.8mm時：3.43 N (参考値)
Height : 3.8mm : 3.43N (Reference value)

標準梱包数量*Standard packaging quantity*

- 梱包形態 / Packaging テーピング Taping
- 数量 / Quantity 1,500ヶ (リール) 1,500/reel

**SM-S706225TG**

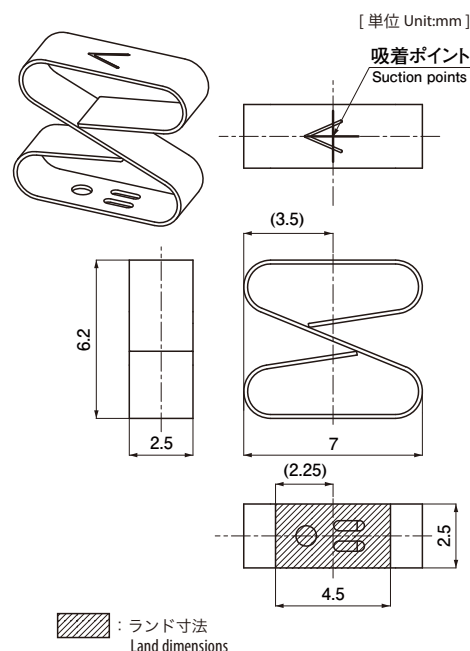
- 推奨弾性使用範囲 / Recommended available Height 高さ = 4.7 ~ 5.6 mm
Height: 4.7 mm to 5.6 mm
- 材質 / Material チタン銅 (t=0.15mm) Titanium copper (t=0.15mm)
- メッキ処理 / Plating 下地メッキ 全面：Niメッキ
Underplating whole surface : Ni plating
全面：金フラッシュ Whole surface : Gold flash

特性*Physical properties*

- 初期抵抗値 / Initial resistance 0.05Ω以下 0.05 Ω or less
- 圧縮荷重 / Compressive load 高さ：4.7mm時：2.77 N (参考値)
Height : 4.7mm : 2.77N (Reference value)

標準梱包数量*Standard packaging quantity*

- 梱包形態 / Packaging テーピング Taping
- 数量 / Quantity 1,200ヶ (リール) 1,200/reel



SM-S707525TG

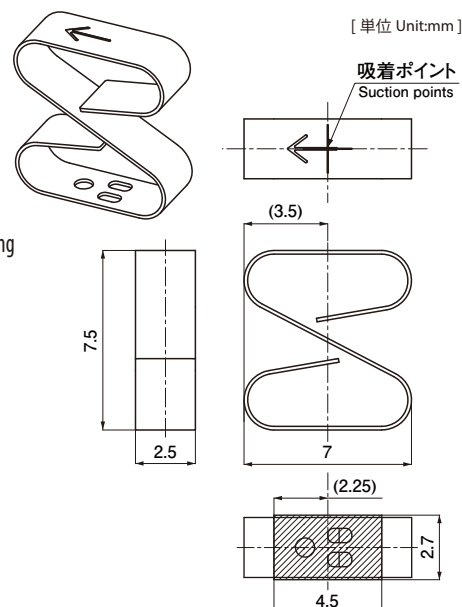
- 推奨弾性使用範囲 / Recommended available Height 高さ = 4.8 ~ 7.2mm
Height: 4.8 mm to 7.2 mm
- 材質 / Material チタン銅 (t=0.15mm) Titanium copper (t=0.15mm)
- メッキ処理 / Plating 下地メッキ 全面：Niメッキ Underplating whole surface : Ni plating
全面：金フラッシュ Whole surface : Gold flash

特性*Physical properties*

- 初期抵抗値 / Initial resistance 0.05Ω以下 0.05 Ω or less
- 圧縮荷重 / Compressive load 高さ：4.8mm時：9.05 N (参考値)
Height : 4.8mm : 9.05N (Reference value)

標準梱包数量*Standard packaging quantity*

- 梱包形態 / Packaging テーピング Taping
- 数量 / Quantity 1,000ヶ (リール) 1,000/reel

**SM-S606720TG**

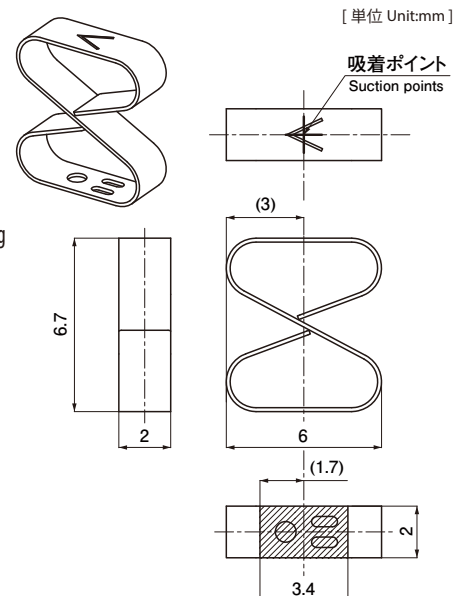
- 推奨弾性使用範囲 / Recommended available Height 高さ = 5.0 ~ 6.2mm
Height: 5.0 mm to 6.2 mm
- 材質 / Material チタン銅 (t=0.15mm) Titanium copper (t=0.15mm)
- メッキ処理 / Plating 下地メッキ 全面：Niメッキ Underplating whole surface : Ni plating
全面：金フラッシュ Whole surface : Gold flash

特性*Physical properties*

- 初期抵抗値 / Initial resistance 0.05Ω以下 0.05 Ω or less
- 圧縮荷重 / Compressive load 高さ：5.0mm時：3.26 N (参考値)
Height : 5.0mm : 3.26N (Reference value)

標準梱包数量*Standard packaging quantity*

- 梱包形態 / Packaging テーピング Taping
- 数量 / Quantity 1,200ヶ (リール) 1,200/reel

**SM-S709025TG**

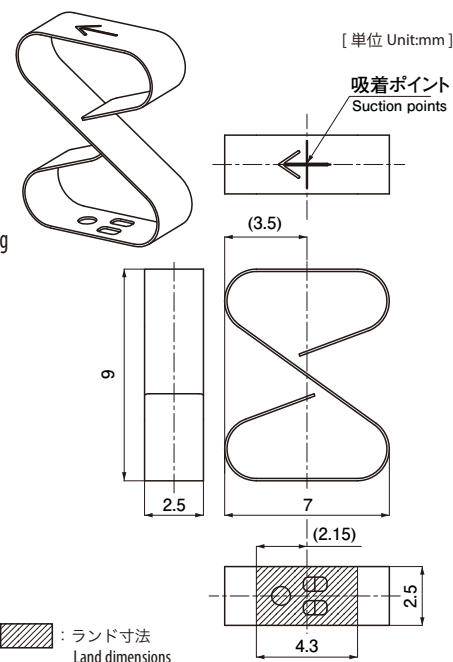
- 推奨弾性使用範囲 / Recommended available Height 高さ = 5.6 ~ 8.7mm
Height: 5.6 mm to 8.7 mm
- 材質 / Material チタン銅 (t=0.1mm) Titanium copper (t=0.1mm)
- メッキ処理 / Plating 下地メッキ 全面：Niメッキ Underplating whole surface : Ni plating
全面：金フラッシュ Whole surface : Gold flash

特性*Physical properties*

- 初期抵抗値 / Initial resistance 0.05Ω以下 0.05 Ω or less
- 圧縮荷重 / Compressive load 高さ：5.6mm時：1.51 N (参考値)
Height : 5.6mm : 1.51N (Reference value)

標準梱包数量*Standard packaging quantity*

- 梱包形態 / Packaging テーピング Taping
- 数量 / Quantity 900ヶ (リール) 900/reel



SM-S701125TG

- 推奨弾性使用範囲 / Recommended available Height 高さ = 6.7 ~ 10.5mm
Height: 6.7 mm to 10.5 mm
- 材 質 / Material チタン銅 (t=0.12mm) Titanium copper (t=0.12mm)
- メッキ処理 / Plating 下地メッキ 全面：Niメッキ Underplating whole surface : Ni plating
全面：Auメッキ Whole surface : Au plating

特 性

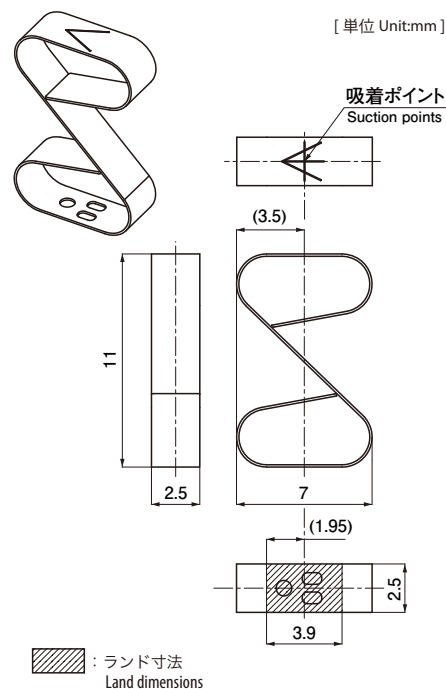
Physical properties

- 初期抵抗値 / Initial resistance 0.05Ω以下 0.05 Ω or less
- 圧縮荷重 / Compressive load 高さ：6.7mm時：1.81 N (参考値)
Height : 6.7mm : 1.81N (Reference value)

標準梱包数量

Standard packaging quantity

- 梱包形態 / Packaging テーピング Taping
- 数 量 / Quantity 400ヶ (リール) 400/reel





SMS type

SMS-402116TGCS

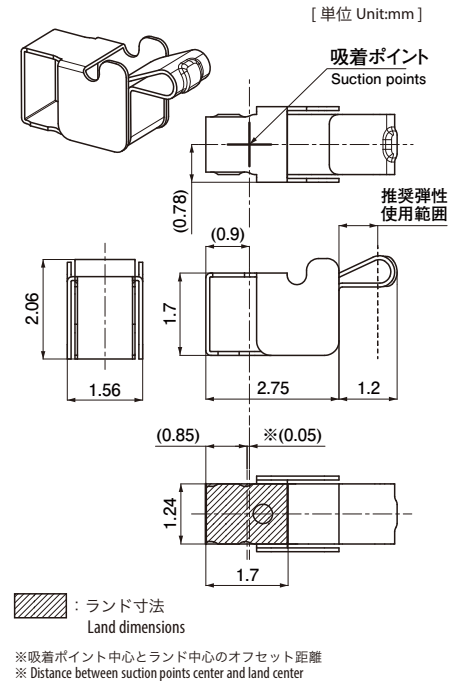
- ▶ 推奨弾性使用範囲 /Recommended available Height 高さ=0.20 ~ 0.80mm
Height: 0.20 mm to 0.80 mm
- ▶ 材 質 /Material チタン銅 (t=0.08mm) Titanium copper(t=0.08mm)
- ▶ メッキ処理 /Plating 下地メッキ 全面：Niメッキ Underplating whole surface : Ni plating
コンタクト面、ハンダ面又は全面：金フラッシュ
Contact area,solder area or whole surface : Gold flash

特 性 Physical properties

- ▶ 初期抵抗値 /Initial resistance 0.05Ω以下 0.05 Ω or less
- ▶ 圧縮荷重 /Compressive load 高さ：0.2mm時：0.97 N (参考値)
Height : 0.2mm : 0.97N (Reference value)

標準梱包数量 Standard packaging quantity

- ▶ 梱包形態 /Packaging テーピング Taping
- ▶ 数 量 /Quantity 7,100ヶ(リール) 7,100/reel



SMS-252112TG

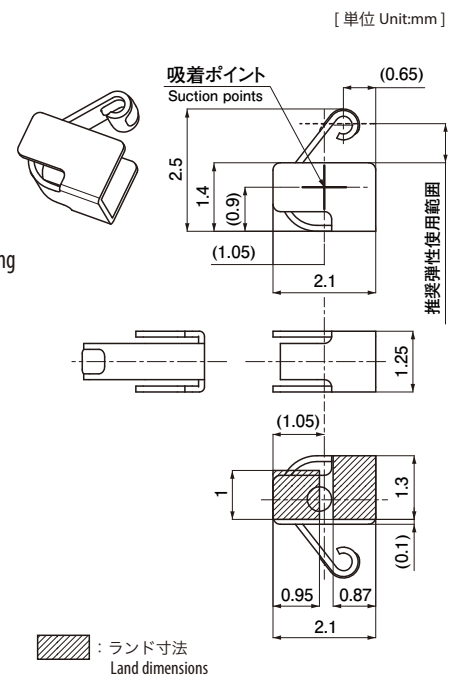
- ▶ 推奨弾性使用範囲 /Recommended available Height 高さ=0.65 ~ 0.80mm
Height: 0.65 mm to 0.80 mm
- ▶ 材 質 /Material チタン銅 (t=0.12mm) Titanium copper(t=0.12mm)
- ▶ メッキ処理 /Plating 下地メッキ 全面：Niメッキ Underplating whole surface : Ni plating
コンタクト面、ハンダ面又は全面：金フラッシュ
Contact area,solder area or whole surface : Gold flash

特 性 Physical properties

- ▶ 初期抵抗値 /Initial resistance 0.05Ω以下 0.05 Ω or less
- ▶ 圧縮荷重 /Compressive load 高さ：0.65mm時：1.99 N (参考値)
Height : 0.65mm : 1.99N (Reference value)

標準梱包数量 Standard packaging quantity

- ▶ 梱包形態 /Packaging テーピング Taping
- ▶ 数 量 /Quantity 4,800ヶ(リール) 4,800/reel



SMS-394722CGCS

■ 推奨弾性使用範囲 / Recommended available Height 高さ = 0.80 ~ 1.30mm
Height: 0.80 mm to 1.30 mm

■ 材 質 / Material 銅合金 (t=0.12mm) Copper alloy (t=0.12mm)

■ メッキ処理 / Plating 下地メッキ 全面：Niメッキ Underplating whole surface : Ni plating
コンタクト面、ハンダ面又は全面：金フラッシュ
Contact area, solder area or whole surface : Gold flash

特 性

Physical properties

■ 初期抵抗値 / Initial resistance 0.05Ω以下 0.05 Ω or less

■ 圧縮荷重 / Compressive load 高さ：0.8mm時：1.84 N (参考値)
Height : 0.8mm : 1.84N (Reference value)

標準梱包数量

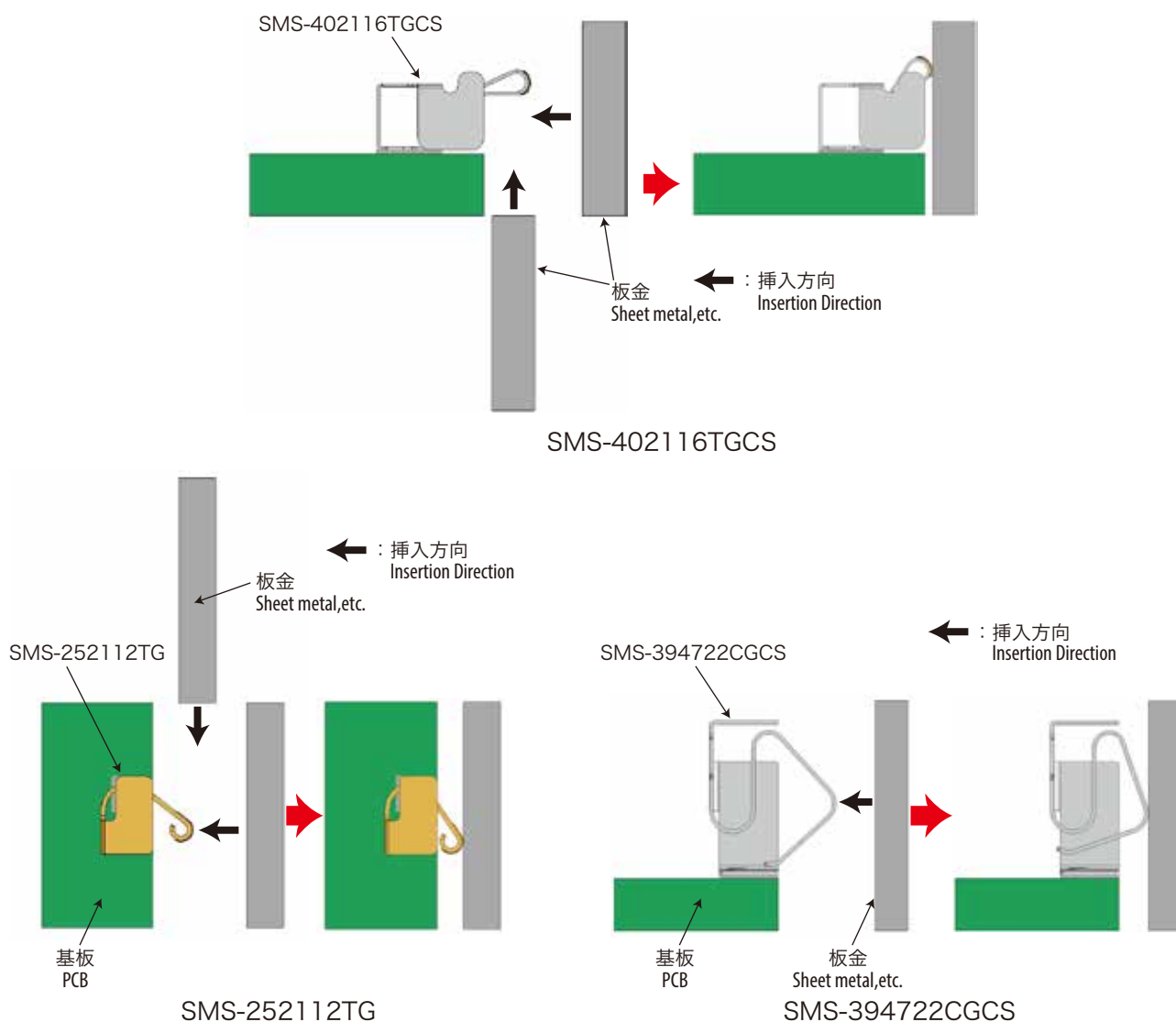
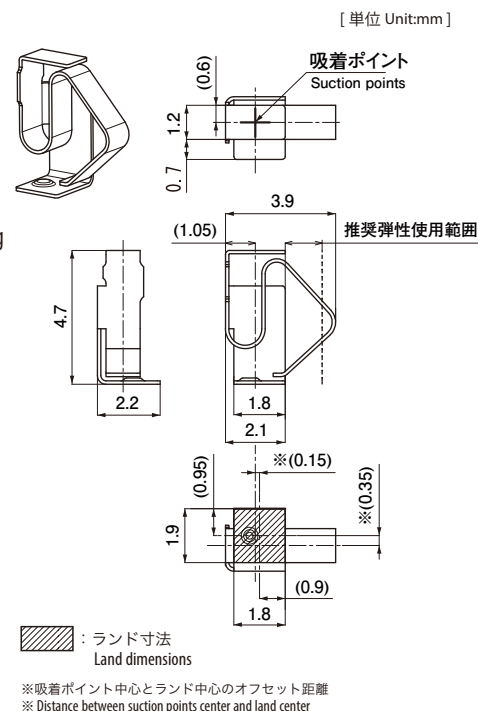
Standard packaging quantity

■ 梱包形態 / Packaging テーピング Taping

■ 数 量 / Quantity 1,700ヶ (リール) 1,700/reel

取付方法

Attachment method



SMC type



SMC-561510SM

- 適応板厚 /Plate thickness..... 0.15 ～ 0.20mm 0.15 mm to 0.20 mm
- 材 質 /Material..... ステンレス鋼 (t=0.15mm)
Stainless steel(t=0.15mm)
- メッキ処理 /Plating.... 下地メッキ 全面：Niメッキ
Underplating whole surface : Ni plating
全面：Snメッキ（無光沢）
Whole surface : Matte Sn plating

標準梱包数量 Standard packaging quantity

- 梱包形態 /Packaging テーピング Taping
- 数 量 /Quantity 2,500ヶ（リール） 2,500/reel

SMC-882514SM

- 適応板厚 /Plate thickness..... 0.20 ～ 0.30mm 0.20 mm to 0.30 mm
- 材 質 /Material..... ステンレス鋼 (t=0.12mm)
Stainless steel(t=0.12mm)
- メッキ処理 /Plating.... 下地メッキ 全面：Niメッキ
Underplating whole surface : Ni plating
全面：Snメッキ（無光沢）
Whole surface : Matte Sn plating

標準梱包数量 Standard packaging quantity

- 梱包形態 /Packaging テーピング Taping
- 数 量 /Quantity 5,000ヶ（リール） 5,000/reel

SMC-883625SM

- 適応板厚 /Plate thickness..... 0.30 ～ 0.50mm 0.30 mm to 0.50 mm
- 材 質 /Material..... ステンレス鋼 (t=0.15mm)
Stainless steel(t=0.15mm)
- メッキ処理 /Plating.... 下地メッキ 全面：Niメッキ
Underplating whole surface : Ni plating
全面：Snメッキ（無光沢）
Whole surface : Matte Sn plating

標準梱包数量 Standard packaging quantity

- 梱包形態 /Packaging テーピング Taping
- 数 量 /Quantity 2,000ヶ（リール） 2,000/reel

*本製品のみでのシールドケース等の保持を保証するものではありません。
*This product alone does not guarantee that a shield case or other item will be held in place.

